

Unternehmen	Name	ALeader Europe Ltd.	CyberOptics Corporation	GÖPEL electronic GmbH	Koh Young Technology	Mek	Mirtec		Omron Europe Ltd.	Parmi Europe GmbH	Pemtron Europe GmbH	Saki Corporation	TRI Test Research, Inc	Viscom AG	Vi Technology	Yamaha Motor Europe N.V.	
Inspektionsmaschine	Name und Model	ALD8720S	SQ3000 3D AOI	Vario Line - 3D	Zenith 2 Seitenkameras	Mek ISO-Spector M1A (mit künstlicher Intelligenz)	Alpha_SIP		VT-S730-HE	Xceed	Eagle 3D 8800	3Di-LS2	TR7500QE	S3088 ultra gold	5K 3D	YSi-V; Type HS2	
	Größe und Gewicht	1085 mm (L) 1275 mm (B) 1570 mm (H) / 920 kg	1190 mm (B) 1270 mm (T) 1390 mm (H) / 965 Kg	1200 mm (B) 1450 mm (T) 1650 mm (H) / 950 kg	L Size – 1000 mm (B) 1530 mm (T) 1805 mm (H) / 850 kg	1070 mm (B) 1550 mm (T) 1500 mm (H) / 800 kg	1080 mm (B) 1492 mm (T) 1560 mm (H)		1100 mm (B) 1470 mm (T) 1500 mm (H) / 800 kg	850 mm (B) 1205 mm (T) 1525 mm (H)	1190 mm (B) 1370 mm (T) 1600 mm (H) / 970 kg	1040 mm (B) 1440 mm (T) 1500 mm (H)	1100 mm (B) 1730 mm (T) 920 kg	800 kg	1110 mm (B) 1351 mm (T) 1892 mm (H) / 900 kg	1252 mm (B) 1498 mm (T) 1550 mm (H) / 1300 kg	
	Max. Größe der Leiterplatte	510x500 mm (Model ALD8730S – 620x550 mm)	Standardsystem: 510x510 mm Großes Leiterplattensystem: 710x610 mm	510mm	(L Size) 330x510 mm (XL Size) 510x690 mm	510x680mm	510x460 mm		510x460 mm	Bis zu 1200 mm LP-Länge und 610 mm LP-Breite	510x510 mm; möglich bis zu 650x1500 mm	Einspurig: 50x60 mm (min) bis 500x510 mm (max) Dual lane: 50x60 mm (min) bis 320x510 mm (max)	519x460 mm möglich 510x590 mm	508x508 mm	533x609 mm	610x560 mm	
	Max. Anzahl der zu prüfenden Komponenten	Keine Begrenzung	Keine Begrenzung	Keine Begrenzung	N/A	Keine Begrenzung	Keine Begrenzung		Bis zu 10.000 Komponenten	Keine Begrenzung	Keine Begrenzung	Keine Begrenzung	Keine Begrenzung	Keine Begrenzung	Keine Begrenzung	Keine Begrenzung	12.800 Komponenten
	Max. Höhe der Komponenten	Oberseite: 40 mm Unterseite: 85 mm	Bis zu 24 mm gemessen in vollem 3D & 30 mm in 2D	40 mm	20 mm	50 mm oberer Abstand, messbar 25 mm	45 mm		25 mm	50 mm	60 mm	Maschinenabstände: • Oben: 40 mm/ • Unten: 50 mm Maximale Messhöhe: 25 mm	50 mm	bis zu 50 mm	34 mm (40 mm optional)	45 mm	
	Geschwindigkeit: Niedrig/Hoch	Hoch	44sq/cm/sec @ 10um + 15sq/cm/sec @ 7um	bis zu 100 cm²/Sek	N/A	Hochgeschwindigkeitsprüfung (FoV 69x69 mm)	4.040 mm²/Sek.		Schnelle Full-3D-Inspektion mit hoher Geschwindigkeit	bis zu 65 cm²/Sek	Nur eine Geschwindigkeit: 58,3 cm²/Sek.	Hohe Geschwindigkeit: 57 sq.cm/s	bis zu 50 cm²/Sek.	Hohe Geschwindigkeit	Bis zu 26 cm²/Sek vollständig in 3D	32.94 cm²/Sek.	
	Leiterplattenabstand	Oberseite: 40 mm	50 mm	40 mm	• 40 mm Oberseite • 50 mm Unterseite	50 mm Oberer Abstand	• 45 mm Oberseite • 50 mm Unterseite		40 mm Oben/Unten	50 mm Oben/Unten	• 3 mm	Maschinenabstände: • Oben: 40 mm • Unten: 50 mm	• 50 mm Oberseite • 40 mm Unterseite	• 50 mm	• 34 mm Oberseite (40 mm optional) • 60 mm Unterseite	• 3 mm vordere und hintere Leiterplatten-seite	
	Monitor Typ/ Touch	23,6" Touch Screen	Touchscreen-Bedienung	24" multi-touch, entspiegelte Oberfläche	N/A	24" Touchscreen-Monitor im Rahmen montiert	24"		Touchscreen	24"	24"	• Screen Size: 24" LCD monitor • Screen Resolution: WUXGA (1920x1200) 24-bit full color	Touchscreen	Ja	22" LCD	Full-HD	
	Betriebssystem	Windows 10 / 64 bit Professional	MS Windows 10	Windows 10 LTSC	Windows 7	Windows 10 Pro	Windows 10		Windows 10	Windows 10	Windows 10	Windows 10	Windows	MS Windows	Windows 10	Windows 7 embedded, 64bit	
	Aspekte der Fertigungslinie abgedeckt werden	Schwerpunkt auf Post-Reflow, Pre-Reflow und Post Wave auch möglich	3D SPI, Pre-Reflow AOI, Post Reflow AOI, Post Wave, Wire Bond, Packaging, CMM, Metrologie	Alle Möglichkeiten werden abgedeckt	Pre-Reflow, Post-Reflow				Pre-/post-reflow, post wave mit unterseitigem Inspektionskopf, Underfill, Die, IGBT, CCOD, etc.					Max. Anzahl der zu prüfenden Komponenten	Pre-Reflow, Post-Reflow oder Post-Wave		
(Sonstiges)			System als Tischversion mit manueller Beladung verfügbar										Max. Höhe der Komponenten				
Bilderfassungssystem	Anzahl der Kameras in der Maschine	1 Kamera	1 x multifunktionaler 3D-MRS-Sensor	4 Kameras mit 12 MegaPixel-Technologie (Schrägblick), 1 Kamera mit 28 MegaPixel-Technologie (Orthogonalblick)	1 (4-seitig - optional)	5 Kameras: 1x Hauptkamera und 4x Seitenkameras	5 Kameras: 1 (Haupt-) Topkamera und 4 Seitenkameras		1x Direktansicht; 4x Winkelansicht	Color Textured Range Scan Kamera Seiten Kameras für 360° Inspektion	Bis zu 5 Kameras	5 Kameras: 1 für orthogonal, 4 für Seitenansicht	5 Hochauflösende Kamerasysteme und 4 Digitale Fringe Pattern Projektoren	9 Kameras	3 Kameras	5 Kameras	
	Typ der Kamera(s)	12 MPixel intelligente Hochgeschwindigkeits-Kamera mit telezentrischer Linse	• Programmierbarer Projektor • 4 x Schrägkameras • 1 x HR-Farb-2D-Kamera	• 4 Schrägblickkameras mit 360 Prüfrichtungen • 1 orthogonale Kamera	12 m Highspeed-Kamera (oben) (Seite 2 m)	• Hauptkamera 25 MPixel mit Coaxpress-Schnittstelle • Seitenkameras 2,5 Megapixel jeweils mit Coaxpress - Schnittstelle	Monochrome		• Die Direktansicht ist das Auge des Systems, um Bilder von einer Leiterplatte mit einer 12MCMOS-Kamera aufzunehmen. • Winkelansicht zur Aufnahme des PCB-Schrägbildes mittels CCD.	UHS-Bildsensor mit FPGA-Echtzeit-Bildverarbeitung	Telecentric High Resolution/ High Speed Kamera	CMOS-Flächenkamera	Mpix	Viscom	• 1 senkrechte Farbkamera 8 MPixel • 12-bit CCD + 2 angewinkelte Kameras für Lasertriangulation	• 1 Zentralkamera • 4 Seitenkameras	
	Fähigkeiten der Kamera(s): HD/3D	N/A	100 % 3D-Messung + Statistische Bildanalyse	3D / 2D / 360 Inspektionsrichtungen / 360 Projektionsrichtungen	3D-Inspektion	Sowohl HD als auch 3D	Topkamera 12MP, Seitenkameras 18MP, Linsenauflösung wahlweise 10 µm oder 15 µm verfügbar		CMOS-Kamera. Volle 3D-Fähigkeiten mit einzigartiger patentierter Technologie	Hochauflösender 3D TRXC Sensorkopf	2D/3D Algorithmen für volles 3D Bild	3D	3D Fringe pattern	HD und 3D	HD und 3D	2D und 3D	